

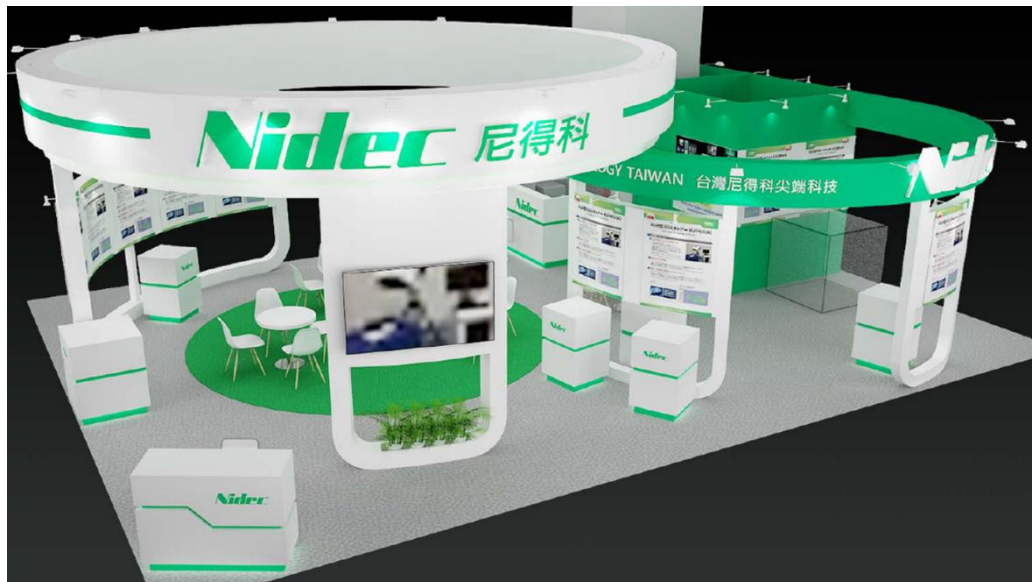
2025 年 9 月 5 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

SEMICON TAIWAN 2025 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 9 月 10 日(水)～9 月 12 日(金)に台北南港展示センターで開催される半導体業界における最新技術と革新を展示するアジア最大級の国際展示会「SEMICON TAIWAN 2025」に出展します。



同展示会は、台湾で最も影響力のある半導体関連イベントであり、本年は「*Leading with Collaboration. Innovating with the World*」をテーマに 56 カ国から 1,100 社を超える企業が出展を予定しています。

半導体業界は今、AI とハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）の需要急増を背景に、「ハイパー・ムーアの法則」の時代を迎えています。処理能力の拡大に伴い半導体関連製品は微細化や実装の複雑化が進んでおり、これに対応した新たな検査技術の開発が急務となっています。

当社は『ONE STOP SOLUTIONS of AI server/EVs』をテーマに、今回の展示会ではウエハ検査用治具「プローブカード」の最新ソリューションの他、当社の誇る光学検査技術、電気検査技術、プロービング技術を紹介し、先端半導体パッケージ向けにウエハ、チップ、基板、パッケージ全てのプロセスにおいて最先端の検査ソリューションを提案いたします。また、最近注目を集めているパワー半導体向け検査装置および搬送ロボットに関しても最先端技術と製品を紹介いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2025 年 9 月 10 日(水)～9 月 12 日(金)
- ・会場：台湾台北南港展示センター (TaiNEX 1)
- ・ブース：Hall1 K2786

〈出展内容〉

- ・高精度、ノイズ影響軽減「2D MEMS プローブカード」
- ・-40℃～200℃計測対応「TC プローブ」
- ・最先端デバイスに対応最小ピッチ 60 μm 「MEMS FLEX プローブカード」
- ・高電圧、高温対応可能「チャンバーヘッド プローブカード」
- ・高温、高電圧、高密度対応プローブ「3H⁺プローブ」
- ・高精度光学式ウェハ検査装置「NSW シリーズ」
- ・ウェハバンプ対応光学式 2D/3D 検査装置「RWi シリーズ」
- ・TGV 向け 光学式 2D/3D 検査ソリューション
- ・FOPLP/RDL 導通検査装置「GATS-7886」
- ・パワー半導体検査システム「NATS-1000 Series」
- ・EV テストベンチ「TDAS-Series」
- ・xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator」
- ・ウェハ搬送ロボットシステム「AVR SMV 3000」 ※ニデックインスツルメンツとの共同開発